

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】令和 5 年 8 月 3 日(2023.8.3)

【国際公開番号】W O 2 0 2 2 / 1 7 2 9 2 1

【出願番号】特願 2022-580635(P2022-580635)

【国際特許分類】

C 0 8 F 2 1 4 / 1 8 (2 0 0 6 . 0 1)

C 0 8 F 2 9 9 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)

B 3 2 B 1 5 / 0 8 2 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 5 K 1 / 0 3 (2 0 0 6 . 0 1)

10

【F I】

C 0 8 F 2 1 4 / 1 8

C 0 8 F 2 9 9 / 0 0

B 3 2 B 1 5 / 0 8 2 B

H 0 5 K 1 / 0 3 6 1 0 H

【手続補正書】

【提出日】令和 5 年 5 月 12 日(2023.5.12)

【手続補正 1】

20

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

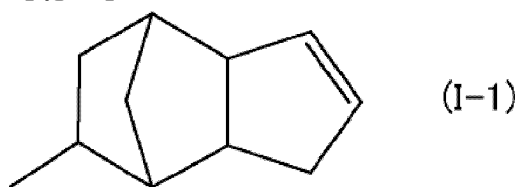
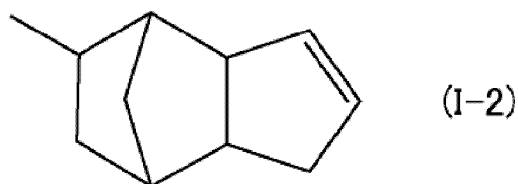
【請求項 1】

主鎖を形成する炭素原子とフッ素原子との間の C - F 結合を有する含フッ素熱硬化性樹脂であって、

下記式 (I-1) で示されるジシクロペンテニル基及び下記式 (I-2) で示されるジシクロペンテニル基からなる群より選択される少なくとも 1 種を有し、

30

【化 1】



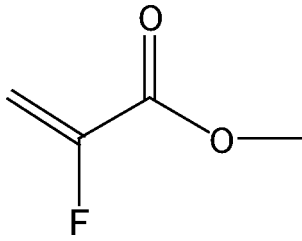
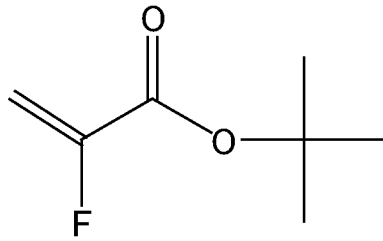
40

前記含フッ素熱硬化性樹脂が含フッ素モノマーとフッ素非含有モノマーとの共重合体であり、

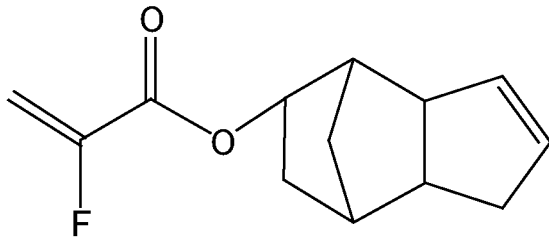
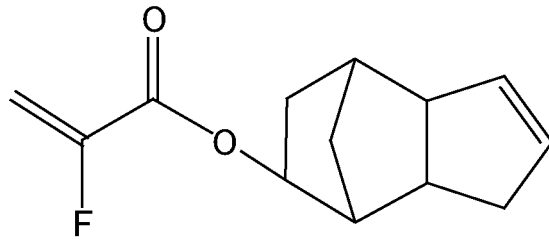
前記含フッ素モノマーは、フッ化ビニリデン、テトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、フッ化ビニル、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）、及び、下記式で示される化合物からなる群より選択される少なくとも 1 種を含み、

50

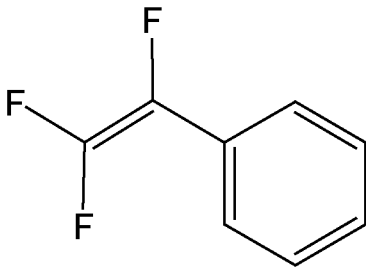
【化 2】



10

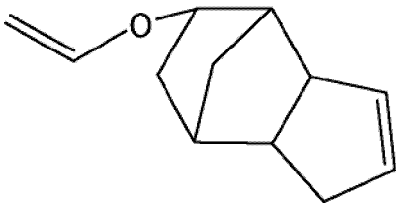
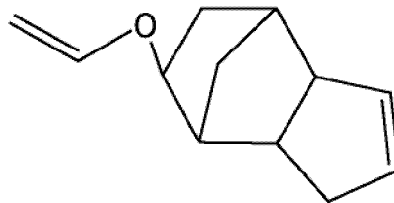


20

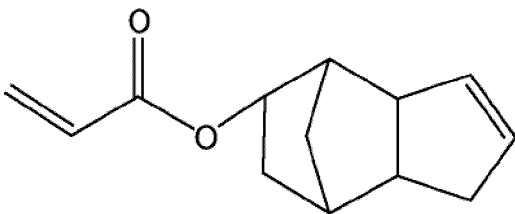
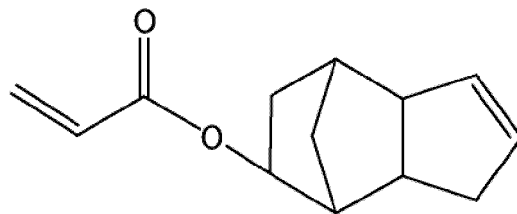


前記フッ素非含有モノマーは、下記式で示される化合物の少なくとも1種を含む含フッ素熱硬化性樹脂。

【化 3】



30



40

【請求項 2】

前記含フッ素熱硬化性樹脂に含まれるフッ素含有量は、前記含フッ素熱硬化性樹脂の全質量に対して、1質量%以上15質量%以下である請求項1記載の含フッ素熱硬化性樹脂。

【請求項 3】

ガラス転移温度が80℃以上である請求項1又は2記載の含フッ素熱硬化性樹脂。

【請求項 4】

数平均分子量が1000～30000である請求項1～3のいずれかに記載の含フッ素熱硬化性樹脂。

【請求項 5】

50

請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の含フッ素熱硬化性樹脂と、溶剤とを含む含フッ素熱硬化性樹脂組成物。

【請求項 6】

請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の含フッ素熱硬化性樹脂を含むフィルム。

【請求項 7】

基材と、前記基材上に設けられた樹脂層とを備える積層体であって、前記樹脂層が、請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の含フッ素熱硬化性樹脂を含む積層体。

【請求項 8】

金属箔と、前記金属箔上に設けられた樹脂層とを備える金属張積層板であって、前記樹脂層が、請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の含フッ素熱硬化性樹脂を含む金属張積層板。

10

【請求項 9】

請求項 8 の金属張積層板の金属箔をエッチングして形成されたパターン回路を備えることを特徴とするプリント基板。

20

30

40

50